

課題番号 : F-12-WS-0039
支援課題名 (日本語) : 新規微細加工・表面加工技術の開発
Program Title (in English) : Development of micromachining and surface treatment
利用者名 (日本語) : 石橋 健一
Username (in English) : Keiichi Ishibashi
所属名 (日本語) : 早稲田大学
Affiliation (in English) : Waseda University

概要 (Summary) :

微細加工や表面加工技術、特に、半導体や樹脂表面への SAM 膜などを用いた製膜・修飾・組成変性について検討している。

当初、通常の写真リソグラフィを用いることを考えていたが、相談の結果、樹脂を使うということで、ナノインプリント装置 (EVG 社製 520) が使えることが分かった。今後、この技術を用い、密着性、加工特性評価などにより、樹脂、シリコンでの最適な材料探査・プロセス条件探査などを検討する。

関連特許 (Patent) :

なし

実験 (Experimental) :

なし

結果と考察 (Results and Discussion) :

なし

その他・特記事項 (Others) :

なし

共同研究者等 (Coauthor) :

なし

論文・学会発表

(Publication/Presentation) :

なし